



华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.

制图	赖谊成
审阅	罗云龙

核准	林钟涛
----	-----

DIP-16

文件名称：
HG-DIP16

文件编号：
HGWXT-230001

版本	V1.0
----	------

比例	1:1
----	-----

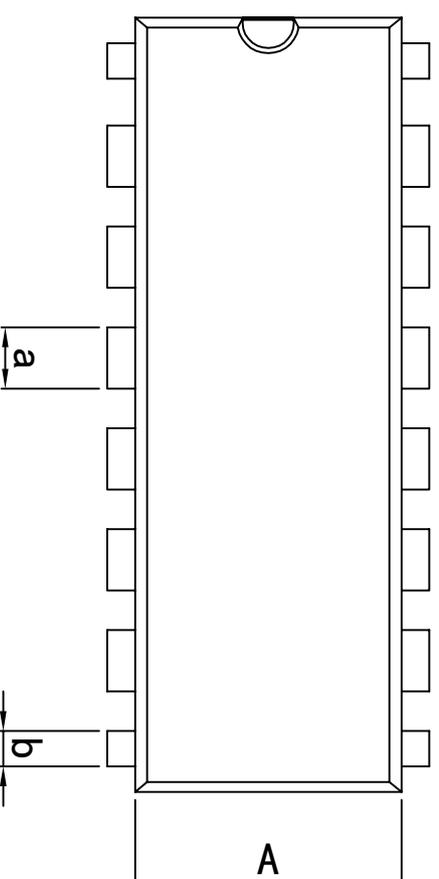
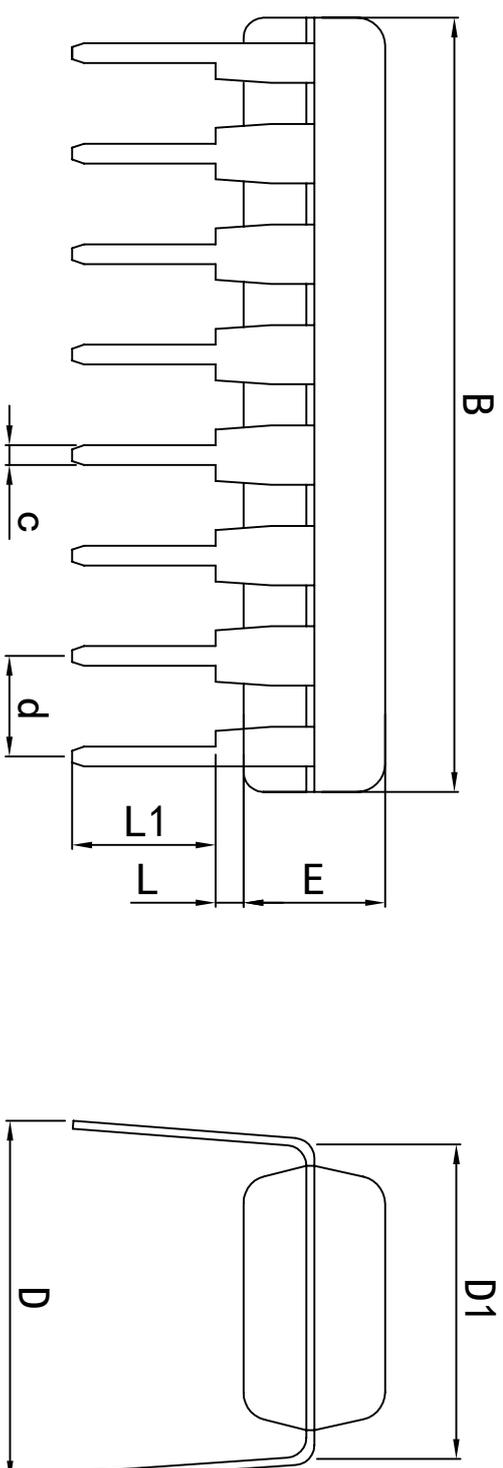
单位	mm
----	----

日期	2023-6-25
----	-----------

图纸幅面	A4
------	----



第一角法



UNITT: mm

DIM.	A	B	D	D1	E	L	L1	a	b	C	d
MIN	6.10	18.94	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.85	0.40	2.54
MAX	6.68	19.56	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.90	0.50	BSC